



インダストリアル向け
組込み開発
プラットフォーム



DIGI CONNECTCORE 8M MINI DEVELOPMENT KIT

インダストリアル向け組込み製品設計のためのすべて揃った開発プラットフォームです。

Digi ConnectCore® 8M Mini開発キットは、NXP® i.MX 8M Miniアプリケーションプロセッサ上に構築された、高集積で費用効果の高いシステムオンモジュール(SOM)プラットフォームです。メモリ、Digi Microcontroller Assist™ パワーマネジメント、電波法認証取得済み(予定)のワイヤレスコネクティビティ、高機能のDigi TrustFence® デバイスセキュリティを、Yocto™ベースのオープンソースLinuxソフトウェアプラットフォームおよびDigi Embedded AndroidによるAndroid開発環境にてインテグレートします。

SOMプラットフォームは、カスタムボード設計の複雑さとリスクを排除することにより、組込み製品開発を簡素化します。Digi ConnectCore 8M Mini開発キットは、複数のディスプレイインタフェース、カメラ、オーディオ、Digi XBee®モジュール、最適な柔軟性とユーザーエクスペリエンスを実現するその他のハードウェアオプションを提供します。

Digi ConnectCore 8M Miniは、パフォーマンス、電力、コストの最適なバランスを実現します。幅広い工業、医療、輸送、農業製品に適しており、スケーラブルで電力効率に優れたARM® Cortex®-A53およびCortex-M4プロセッサ、豊富なマルチメディア、高度なコネクティビティを備えています。Digi ConnectCore 8M Miniは、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、機器監視、オーディオ/音声、エッジコンピューティング、機械学習といったIoT(モノのインターネット)アプリケーションに最適です。この開発ボードには、セルラー、ショートレンジおよびロングレンジコネクティビティを可能にする2つのDigi XBeeコネクタが含まれています。

20年に渡る組込みSOMの経験により、数百万ものグローバルなコネクテッド製品を実現してきたDigiは、信頼できる組込み・IoTソリューションプロバイダであり、カスタマがコネクテッドアプリケーションを設計、構築、配備する方法を簡素化します。Digiは、セルラーインテグレーションサポート、認証支援、カスタムデザイン、ビルドサービスも提供し、製品をよりスマートかつ迅速に市場に投入できます。

キットの内容:

- ✓ Digi ConnectCore®8M Mini開発ボード
- ✓ コンソールポートケーブル
- ✓ デュアルバンドアンテナ
- ✓ 電源とアクセサリ
- ✓ LVDS、HDMI、CAN-FDのリファレンスデザイン

PART NUMBER	DESCRIPTION
CC-WMX8MM-KIT	Digi ConnectCore 8M Mini development kit

機能と特徴:

- インダストリアル向けi.MX 8M Miniクアッドコアシステムオンモジュール(SOM)
- Yocto Project™をフルサポートするDigi Embedded Yocto(Linux)
- AndroidをフルサポートするDigi Embedded Android
- 内蔵VPUによるビデオ機能
- すべて揃ったIoTデバイスセキュリティフレームワーク、Digi TrustFence®
- 高機能パワーマネジメント、セキュリティ、ペリフェラルサポート、システム信頼性動作を実現するDigi Microcontroller Assist™
- 電波法認証取得済みのデュアルバンド802.11a / b / g / n / ac およびBluetooth®5コネクティビティ
- クラウドとエッジコンピューティングサービスの統合
- 開発ボードにはオンボードインタフェース搭載
 - HDMIまたはLVDSディスプレイ
 - 一般的なIoTプロトコルをカバーするグローバルモジュールファミリにワイヤレスコネクティビティを拡張するDigi XBee®インテグレーション

SPECIFICATIONS		Digi ConnectCore® 8M Mini Development Board	
性能			
アプリケーションプロセッサ		NXP i.MX 8M Mini Quad GPU Industrial <ul style="list-style-type: none">• Cortex-A53コア 最大1.6 GHz×4• Cortex-M4 400 MHzコアプロセッサ(低電力プロセッシング)	
メモリ		最大8 GB eMMC, 最大2GB LPDDR4 (32ビット)	
有線ネットワークコネクティビティ			
イーサネット		Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ-45コネクタ付属)	
無線ネットワークコネクティビティ			
Wi-Fi		802.11a/b/g/n/ac1×1 (MCS 0-9) strong WPA2-enterprise authentication/encryption for Wi-Fi	
Bluetooth		Bluetooth® 5 (Bluetooth Low Energy対応)	
アンテナ		SMA アンテナコネクタ	
Digi XBee® RF		Digi XBee ソケット×2、1つはDigi XBee Cellular対応	
ペリフェラル/インタフェース			
USB		USB host (dual Type A)×2	
GPIO		GPIO×5	
UART/コンソール		USB コンソール	
その他のコネクティビティ		CAN-FD×1、RS-485	
PCI Express Mini Card		フルサイズカード対応(USB接続およびオンボードmicro-SIMスロット対応)	
外部ストレージ		MicroSDコネクタ	
オーディオ		3.5 mmヘッドフォンジャック、3.5 mmマイクロフォンジャック、スピーカー出力× 2、line-out、line-in×2	
ボタン/スイッチ		リセットボタン×1、on/offボタン(power-on/off、suspend/resume)、ユーザーボタン×2	
デバッグ		SW for MCA (Tag-connect)、JTAG for i.MX 8M Nano CPU、USB(SOMリカバリ)	
LED		User LED×3	
マルチメディア			
ディスプレイ		HDMI、LVD (backlight control , I2C touch interface)、MIPI-DSI (注): 一度に動作できるディスプレイインタフェースは1つのみ	
カメラ		MIPI-CSI カメラコネクタ : 2つのデータレーンに対応(拡張コネクタにより2つの追加データレーンが利用可能)	
電力条件			
供給電圧		5 VDC	
電源コネクタ		5 V入力ジャックコネクタ、supercap (RTCアプリケーションをサポートする開発ボードに搭載)、coin-cell/supercapコネクタ、バッテリーコネクタ	
動作環境			
動作温度		-40℃～85℃	
保管温度		-50℃～125℃	
相対湿度		5%～90% (結露なきこと)	
外形寸法		130 mm x 210 mm	

ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F
TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp
www.digi-intl.co.jp

